

2012年3月期 中間決算説明会

2011年10月31日

東京エレクトロン デバイス株式会社



東京エレクトロン デバイス株式会社

決算報告

代表取締役副社長

久我 宣之

連結業績 前年同期比較

(単位:百万円)

	2011年3月期		2012年3月期		増減額	増減率 (%)
	中間	百分比%	中間	百分比%		
売上高	45,535	100.0	41,787	100.0	▲3,748	▲8.2
売上総利益	7,726	17.0	7,322	17.5	▲403	▲5.2
営業利益	1,150	2.5	822	2.0	▲328	▲28.5
経常利益	1,247	2.7	1,263	3.0	16	1.4
中間純利益	861	1.9	699	1.7	▲162	▲18.9
1株当たり 中間純利益	8,129.19円		6,595.43円			
R O E	7.8%		6.0 %			
従業員数	879人		906人			

連結業績 中間予想・実績比較

(単位:百万円)

	2012年3月期中間		2012年3月期中間		増減額	増減率 (%)
	年初予想	百分比%	実績	百分比%		
売上高	44,000	100.0	41,787	100.0	▲2,212	▲5.0
営業利益	1,145	2.6	822	2.0	▲322	▲28.2
経常利益	1,100	2.5	1,263	3.0	163	14.9
中間純利益	630	1.4	699	1.7	69	11.0

連結資産

(単位:百万円)

科目	2011年 3月31日現在	2011年 9月30日現在	増減額
現預金	1,373	1,437	64
受取手形・売掛金	21,025	18,621	▲2,403
たな卸資産	19,347	17,981	▲1,365
その他流動資産	3,505	4,404	898
有形固定資産	1,469	1,391	▲78
無形固定資産	390	407	17
投資その他の資産	3,143	3,063	▲80
資産計	50,254	47,306	▲2,947

連結負債・純資産

(単位:百万円)

科目	2011年 3月31日現在	2011年 9月30日現在	増減額
買掛金	7,360	6,528	▲831
短期借入金	7,996	5,152	▲2,844
その他流動負債	5,923	6,136	212
固定負債	5,753	5,955	201
負債計	27,034	23,772	▲3,261
資本金	2,495	2,495	—
資本剰余金	5,645	5,645	—
利益剰余金	15,238	15,555	317
その他包括利益累計額	▲158	▲162	▲3
純資産計	23,220	23,534	314
負債・純資産計	50,254	47,306	▲2,947

連結キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2011年3月期 中間	2012年3月期 中間	増減額
営業キャッシュ・フロー	▲1,316	3,408	4,724
投資キャッシュ・フロー	▲145	▲143	2
財務キャッシュ・フロー	1,247	▲3,193	▲4,440
現金及び現金同等物 中間期末残高	1,386	1,437	50

セグメント別 前年同期比較

(単位:百万円)

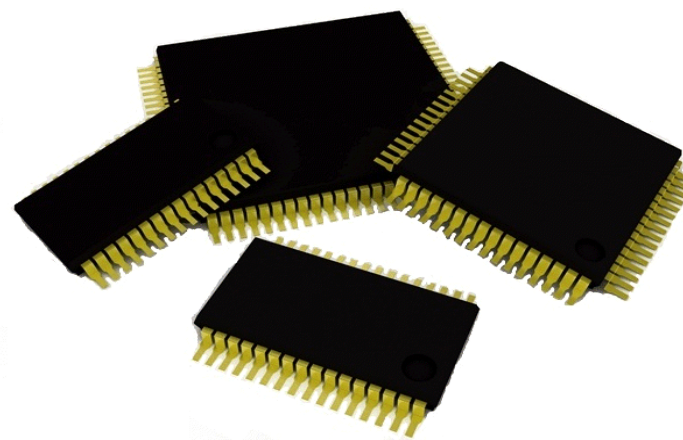
セグメント	2011年3月期 中間		2012年3月期 中間					
	売上高	セグメント 利益	売上高	増減額	増減率 (%)	セグメント 利益	増減額	増減率 (%)
半導体及び 電子デバイス	37,475	1,123	33,170	▲4,305	▲11.5	675	▲447	▲39.9
コンピュータ システム関連	8,059	123	8,617	557	6.9	587	464	377.6
合 計	45,535	1,247	41,787	▲3,748	▲8.2	1,263	16	1.4

セグメント別 中間予想・実績比較

(単位:百万円)

セグメント	2012年3月期 年初中間予想		2012年3月期 中間実績					
	売上高	セグメント 利益	売上高	増減額	増減率 (%)	セグメント 利益	増減額	増減率 (%)
半導体及び 電子デバイス	35,300	710	33,170	▲2,129	▲6.0	675	▲34	▲4.8
コンピュータ システム関連	8,700	390	8,617	▲82	▲1.0	587	197	50.8
合 計	44,000	1,100	41,787	▲2,212	▲5.0	1,263	163	14.9

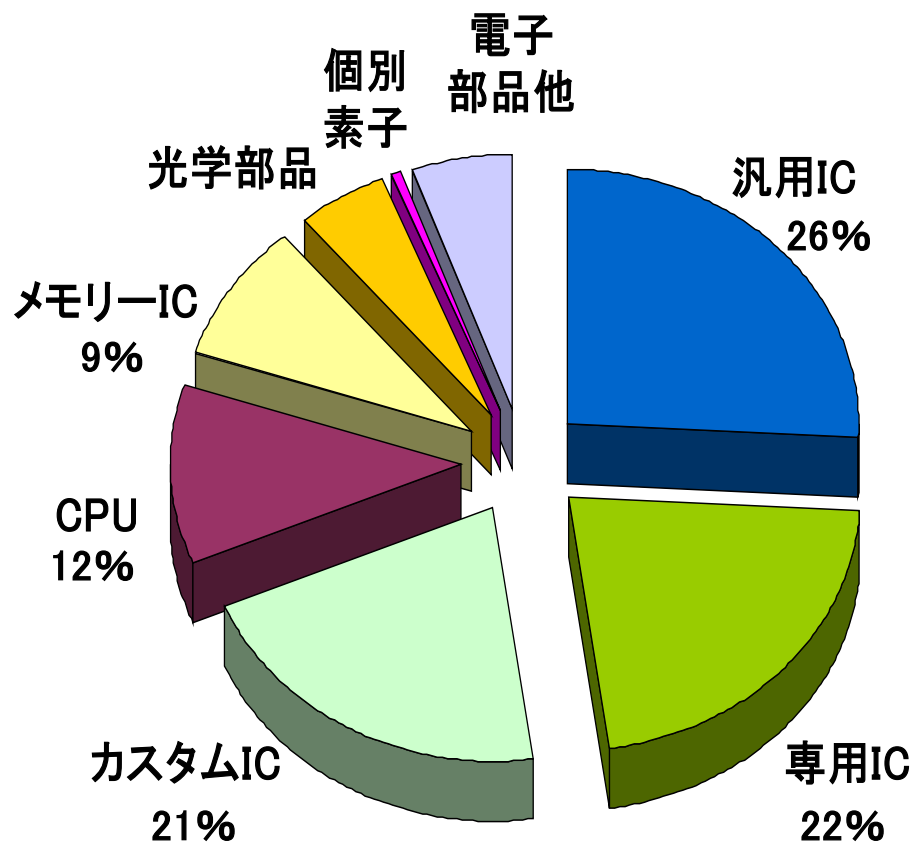
半導体及び電子デバイス事業



半導体及び電子デバイス事業 品目別売上構成

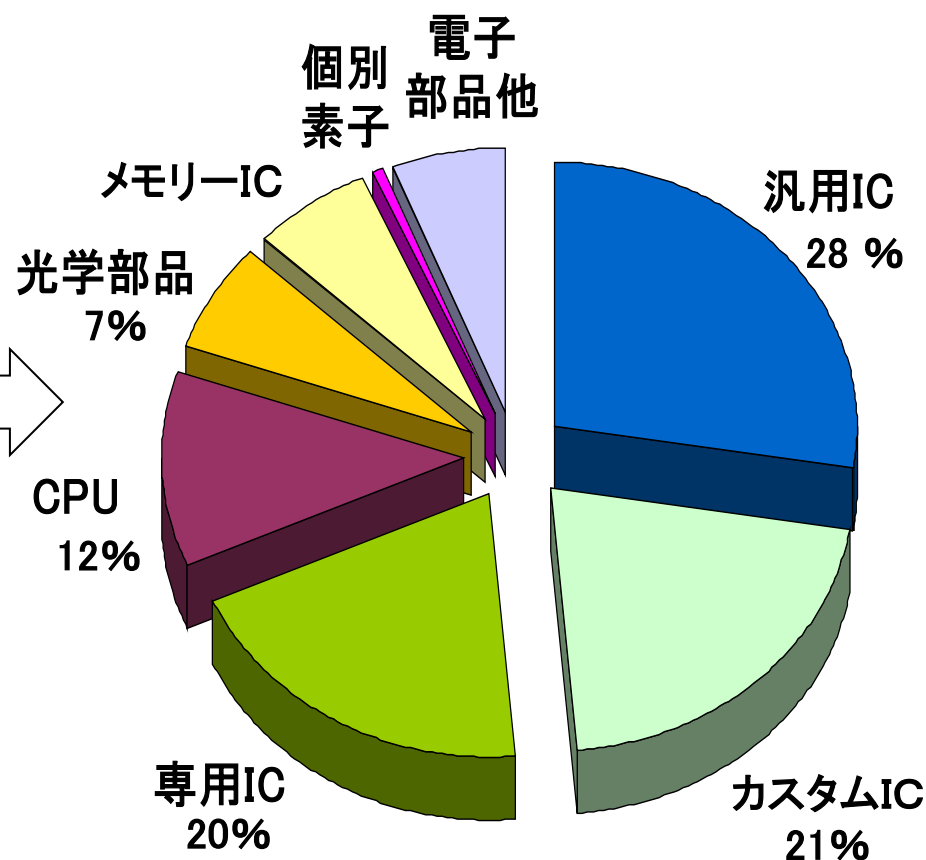
<2011年3月期中間 内訳>

売上高：37,475百万円



<2012年3月期中間 内訳>

売上高：33,170百万円



* 品目についての説明は、P.36～P.38をご参照ください。

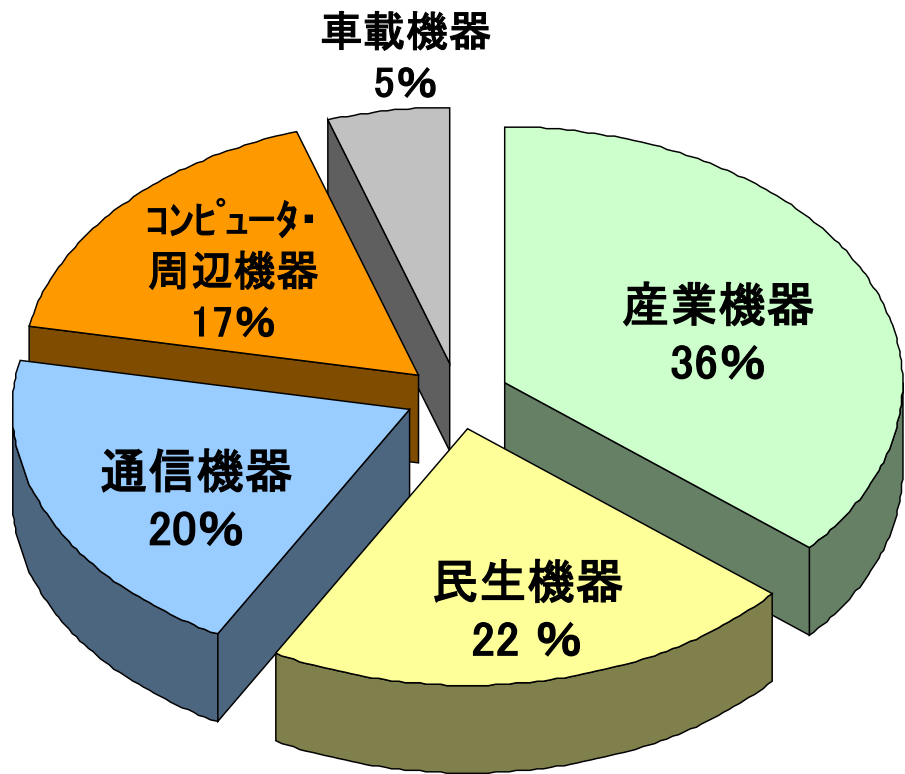
品目別 売上増減

主な品目	主な仕入先	対前年増減率	主な要因
汎用IC	リニアテクノロジー、TI	▲6%	産業機器は比較的堅調も TVを中心とした民生機器向け減少
カスタムIC	ザイリンクス、富士通	▲10%	通信基地局向け堅調も 医療機器、民生機器向け減少
専用IC	ピクセルワークス、ビクシス、 シリコンイメージ、フリースケール	▲21%	AVアンプ、TVなど民生機器向け減少
CPU	フリースケール、富士通、TI	▲10%	複合プリンタ向け減少
光学部品	アバコ・テクノロジー	16%	携帯電話向け増加

注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

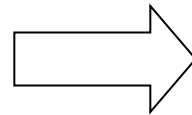
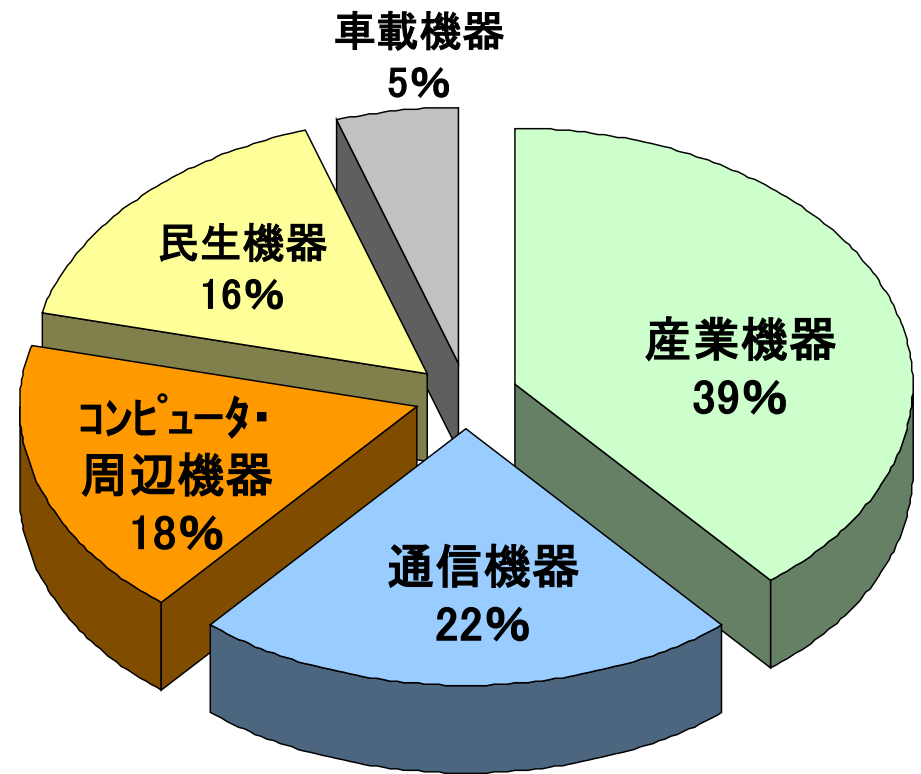
＜2011年3月期中間 内訳＞

売上高：37,475百万円



＜2012年3月期中間 内訳＞

売上高：33,170 百万円



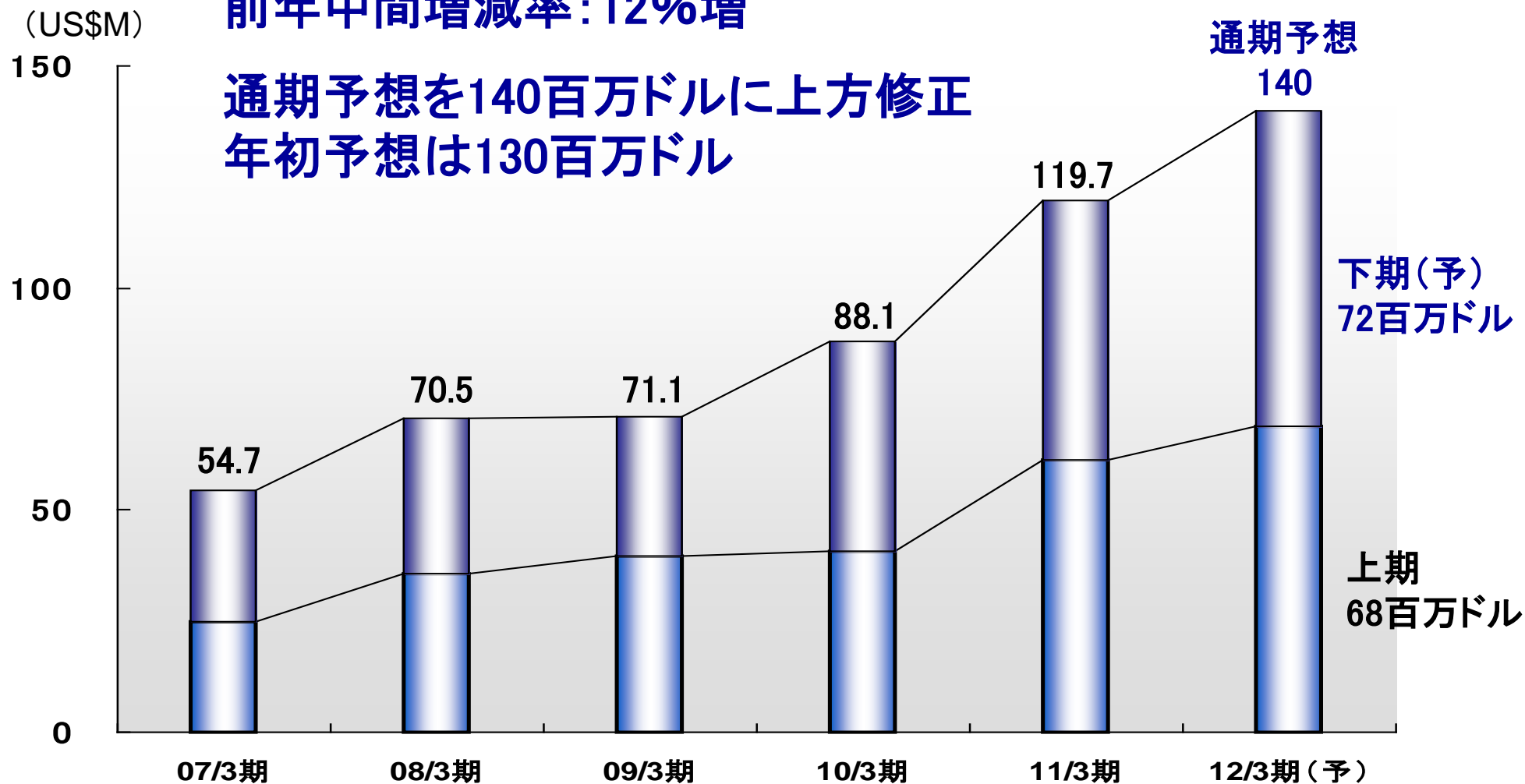
用途別 傾向

用途	主なアプリケーション	当社の傾向
産業機器	医療機器、放送機器、テスター、半導体製造装置、ロボット、計測器、工作機器	全般的に堅調も医療機器は減少
通信機器	携帯電話、ルーター、伝送装置、基地局	基地局堅調、携帯電話は光学部品が好調
コンピュータ・周辺機器	複合プリンター、液晶プロジェクタ、PC及び付属機器	液晶プロジェクタは堅調も複合プリンタ低調
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、薄型TV、AV機器	TVを中心に大幅減
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ	カーナビゲーション低調

海外子会社売上高推移

中間売上高：68百万ドル
前年中間増減率：12%増

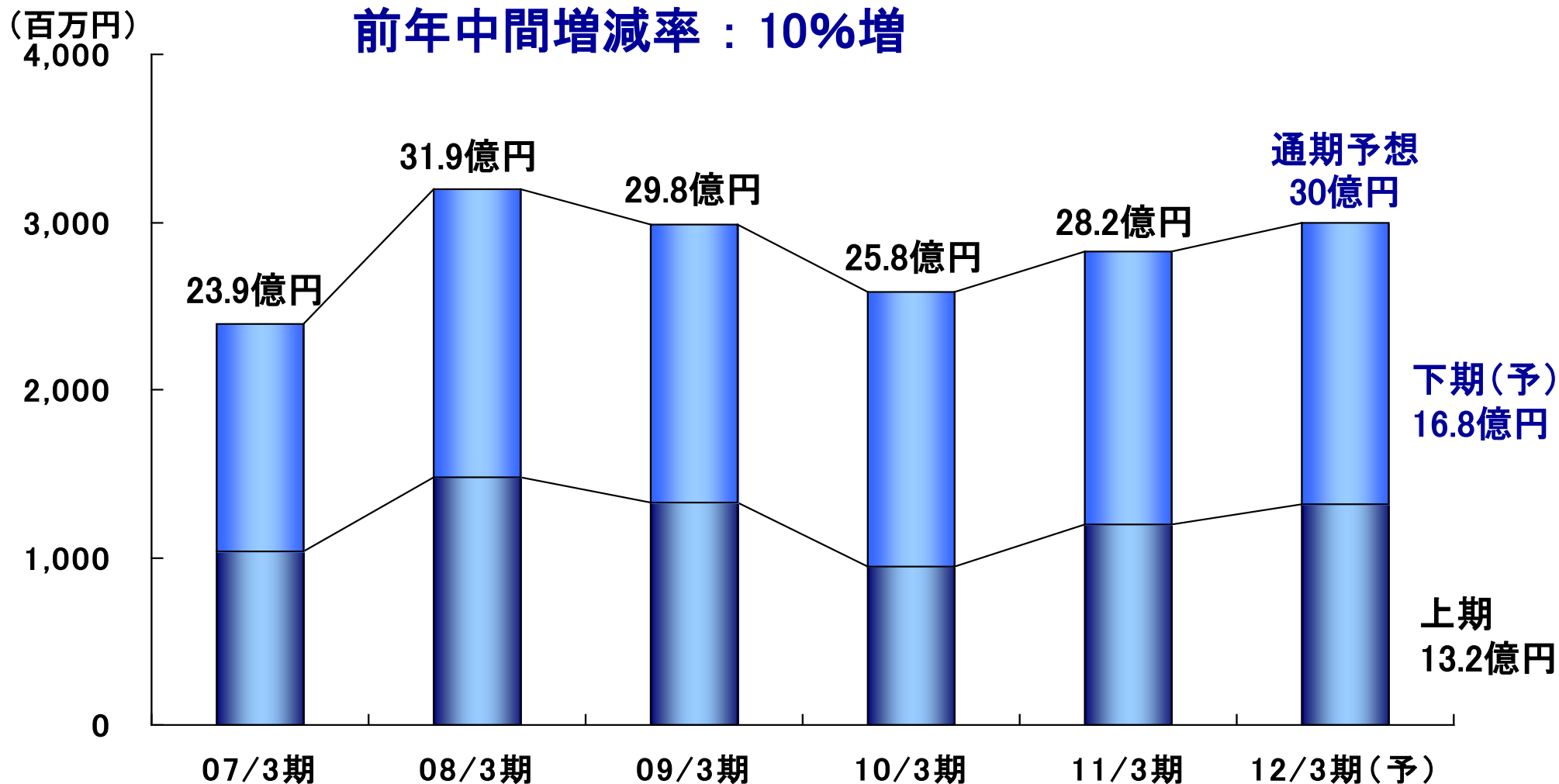
通期予想を140百万ドルに上方修正
年初予想は130百万ドル



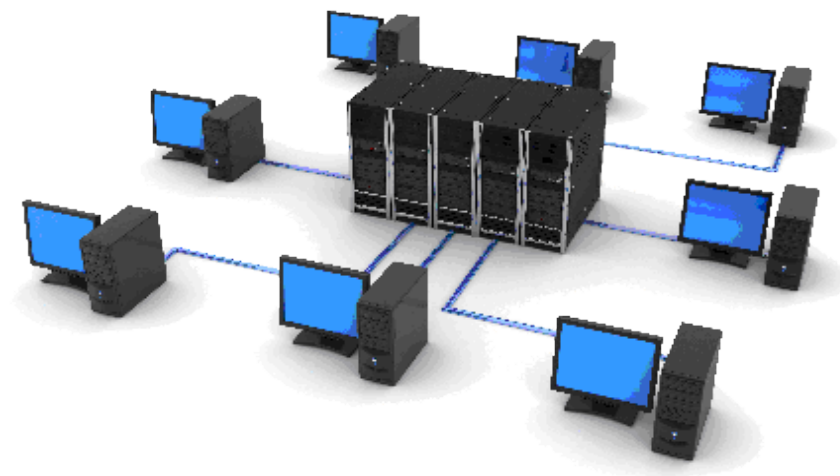
開発ビジネス(インレビウム)売上高推移

中間売上高：13億円

前年中間増減率：10%増

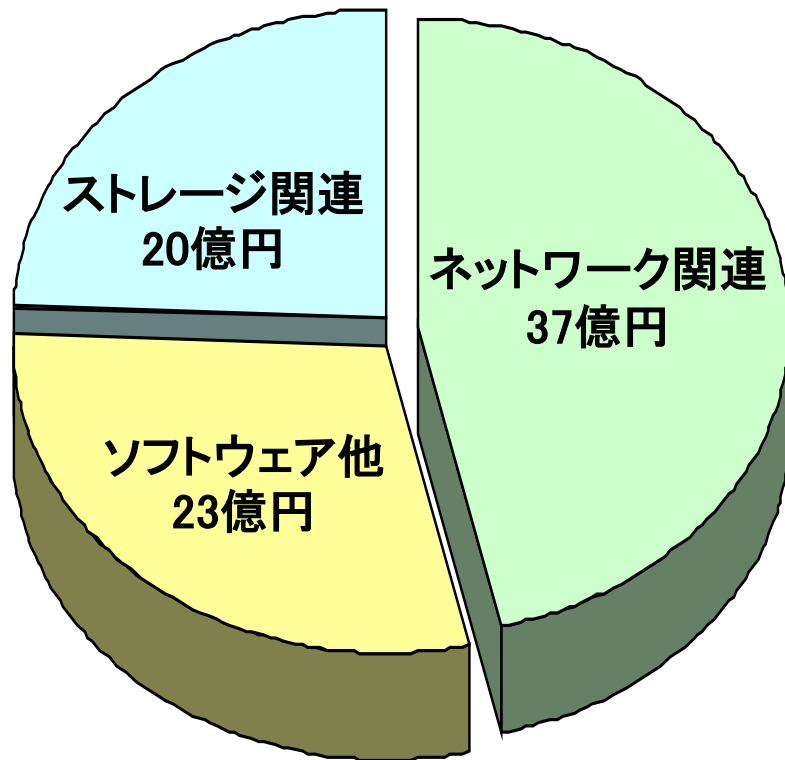


コンピュータシステム関連事業



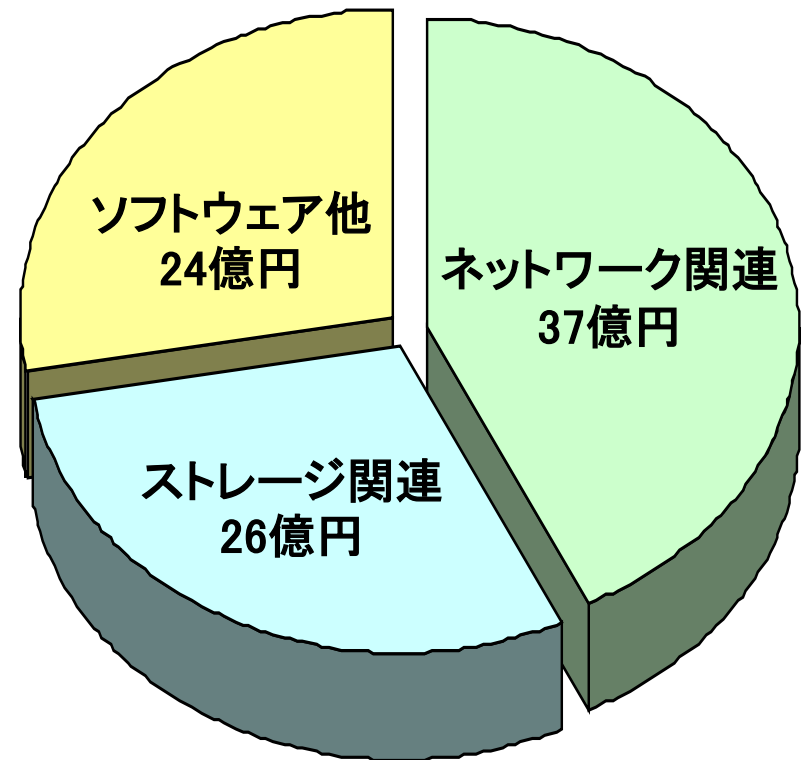
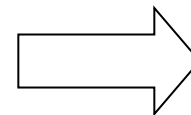
＜2011年3月期中間 内訳＞

売上高：8,059百万円



＜2012年3月期中間 内訳＞

売上高：8,617百万円



品目別売上増減要因

品目	主な仕入先	対前年増減率	主な要因
ネットワーク関連	F5ネットワークス	▲2%	企業向け製品販売低調、保守堅調
ストレージ関連	ブロード	29%	データセンター向けIT投資増加
ソフトウェア他	マイクロソフト	2%	POS端末向けソフトウェア堅調

注)社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

- 2012年3月期中間レビュー
- 2012年3月期業績見込み
- 配当について

代表取締役社長

栗木 康幸

2012年3月期中間レビュー

今期特に力を入れる経営テーマ

◆2011年5月2日 決算説明会時発表内容

次世代を担う 商材と人材の創出

- ・次世代人材の登用と育成

<半導体及び電子デバイス>

- ・プロダクト企画の機能を強化
- ・大口顧客様直結の部を設置
- ・設計・開発能力の一層の向上

<コンピュータシステム関連>

- ・取り扱い製品の選択と集中

海外事業の 一層の促進

- ・TED香港を海外本社とするアジア組織体制への変更と強化

- ・現地企業の開拓及び販売促進

- ・本社の役員を配置

新事業部門

- ・グリーンプロダクト推進部を新事業推進部に改称
- ・幅広い商材の取り込みを図る

- ・Eトレードシステムを導入

◆ 新規代理店契約締結＝新商材

2011年7月 : 「Powercast社」(新事業推進部)

電波からエネルギーハーベストデバイス

2011年7月 : 「Nicira Networks社」(コンピュータシステム関連)

ネットワーク仮想化ソフトウェア

2011年1月 : 「Fusion-io社」(コンピュータシステム関連)

ストレージ製品

2010年12月 : 「Memsic社」(半導体及び電子デバイス)

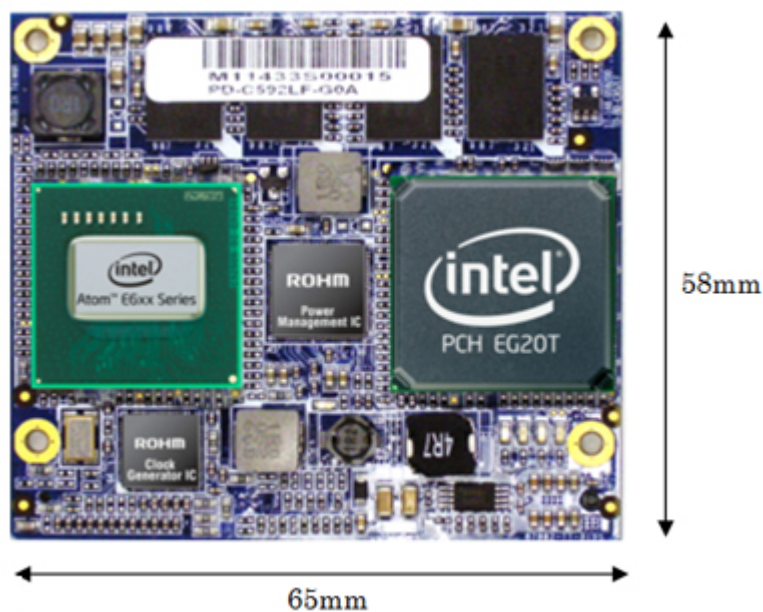
MEMSセンサ

2010年10月 : 「Semikron社」(半導体及び電子デバイス)

パワー半導体

◆ 小型CPUモジュールを開発

- インテル®Atom™ プロセッサ E600番台を搭載
- 小型CPUモジュール上にパソコンの基本機能を実現
- 省スペース化、低消費電力、開発期間の短縮に効果を発揮
- 2011年11月販売受付開始



<主な応用分野>

インターネット接続可能な組み込み機器
医療機器、車載機器、電子看板など

「CoreE600 (TD-BD-C592LF)」

海外営業展開



◆ TED香港に本社役員を配置 海外強化

現在アジアに6拠点

2010年12月マレーシア開設

アメリカ
シリコンバレー
駐在員

大連

上海

深圳

香港

マレーシア

シンガポール

◆ 環境・省エネルギー関連商品

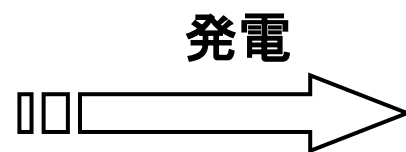
<環境発電デバイス>

無線 RF

電波からの発電が可能



パワーキャスト社



<高機能リチウム電池>

発電した電力を蓄電



インフィニット・パワー・ソリューションズ社

◆ レスキューロボットコンテストに特別協賛

「技術を学び人と語らい災害に強い世の中をつくる」
というレスキューロボットコンテストの理念に賛同
CSR(企業の社会的責任)の一環として特別協賛



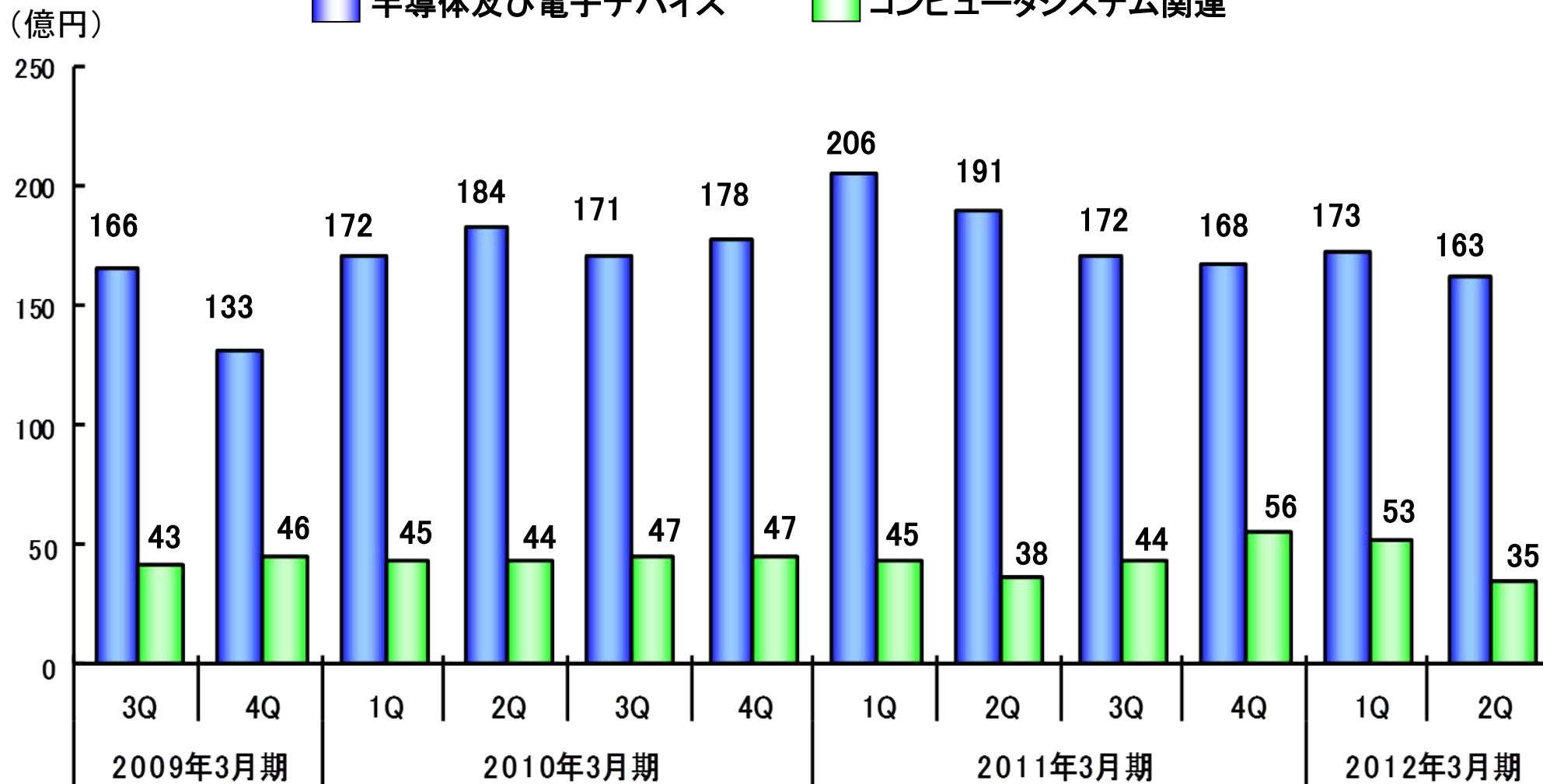
競技会本選

2011年8月6日(土)、7日(日)
神戸サンボーホールにて開催

2012年3月期業績見込み

受注高推移

■ 半導体及び電子デバイス ■ コンピュータシステム関連



【半導体及び電子デバイス事業】

- ・ 上期：民生機器向けの需要が想定より大幅に減少、その他の分野は、ほぼ想定通り。
- ・ 下期：厳しい環境続くが、商権移管が寄与。

【コンピュータシステム関連事業】

- ・ 上期：企業のIT投資は全体的に慎重だが、クラウドやデータセンター向けなどの需要あり。
- ・ 下期：下期偏重の傾向あり、回復を想定。

セグメント別 連結売上高予想

(単位:百万円)

セグメント	2011年 3月期	2012年 3月期	2012年 3月期				
	通期 実績	年初 予想 (A)	中間 実績	下期 予想	通期 予想 (B)	対年初予想比	
						増減額 (B) - (A)	増減率 (%)
半導体及び 電子デバイス	73,354	75,800	33,170	36,213	69,383	▲6,417	▲8.5
コンピュータ システム関連	17,961	19,200	8,617	10,000	18,617	▲583	▲3.0
合 計	91,315	95,000	41,787	46,213	88,000	▲7,000	▲7.4

2012年3月期 連結業績予想

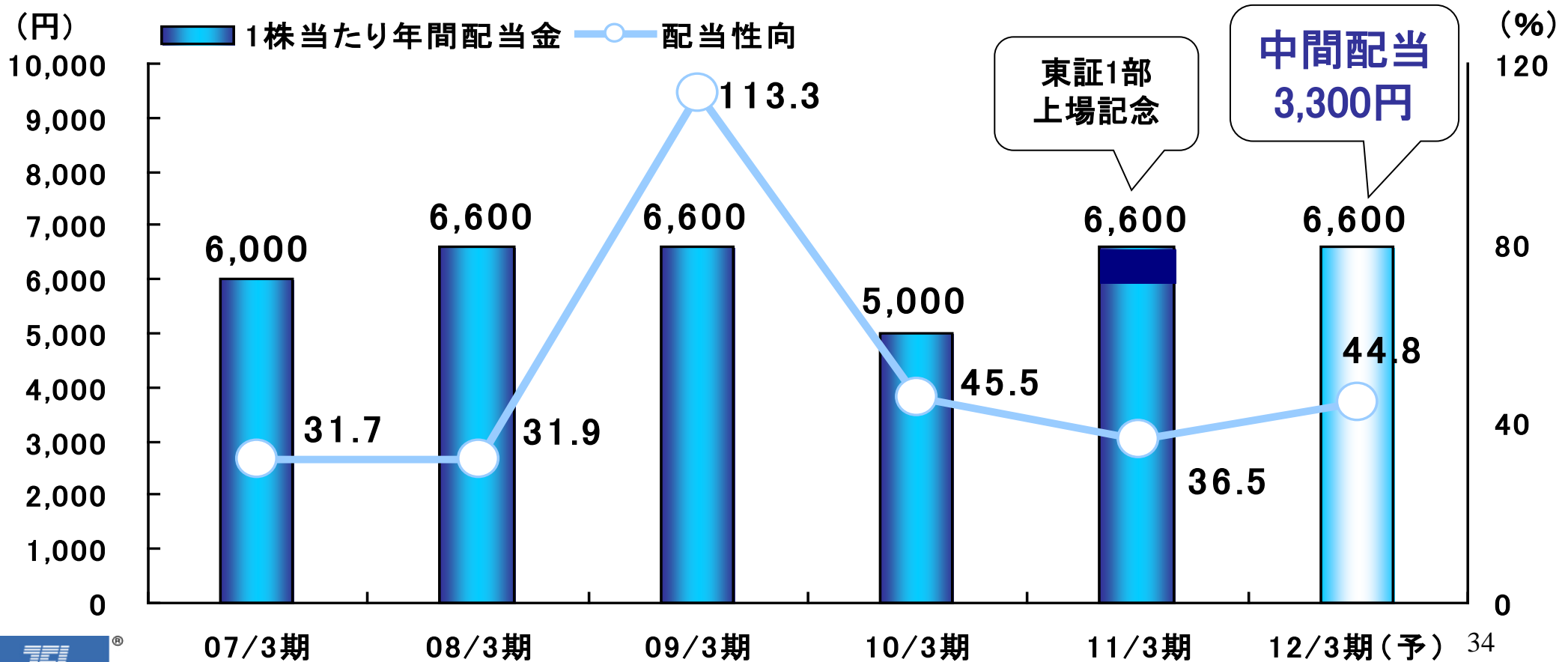
(単位:百万円)

	2011年 3月期	2012年 3月期	2012年 3月期				
	実績	年初 予想 (A)	中間 実績	下期 予想	通期 予想 (B)	対年初予想比	
						増減額 (B) - (A)	増減率 (%)
売上高	91,315	95,000	41,787	46,213	88,000	▲7,000	▲7.4
営業利益	2,745	3,370	822	1,553	2,375	▲995	▲29.5
経常利益	2,941	3,250	1,263	1,487	2,750	▲500	▲15.4
当期純利益	1,918	1,950	699	861	1,560	▲390	▲20.0

配当について

配当について

- ◆ 継続的かつ安定的な配当の実施を基本として、業績を反映した適正な利益還元を原則
- ◆ 当面の配当性向水準：連結当期純利益の35%程度を目安



資料取扱い上の注意



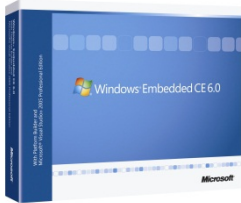
このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界及びIT業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。

セグメント・品目		主な仕入先名
半導体及び 電子デバイス 事業	汎用IC	リニアテクノロジー社、オン・セミコンダクター社、TI 社
	カスタムIC	富士通セミコンダクター(株)、ザイリンクス社、インビーム
	専用IC	カビウム・ネットワークス社、コネクサントシステムズ社、フリースケール・セミコンダクタ社、富士通セミコンダクター(株)、インターシル社、ピクセルワークス社、シリコンイメージ社、TI社、ビクスシステムズ社、ザーリンク・セミコンダクター社、インビーム
	CPU	フリースケール・セミコンダクタ社、富士通セミコンダクター(株)、TI 社
	光学部品	アバゴ・テクノロジー社
	メモリーIC	IDT社、ラムトロンインターナショナル社、スパンション社
	個別素子	オン・セミコンダクター社
	電子部品他	コーセル(株)、インビーム
コンピュータシステム 関連事業	ネットワーク機器	エクストリームネットワークス社、F5ネットワークス社
	ストレージ関連	ブロード社、エミュレックス社
	ソフトウェア他	マイクロソフト社、オラクル社、センセージ社

品目	主な取扱商品	機能
汎用IC	汎用リアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
カスタムIC	ASIC、PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
メモリーIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
個別素子	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品
電子部品他	ボード、電源、コネクタ	プリント配線基板上にIC、電源、コネクタなどの 部品を実装した製品(ボード)

<p>ネットワーク関連</p>		<p>インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ) 企業向けネットワークシステム構築機器。</p>
<p>ストレージ関連</p>		<p>SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など。</p>
<p>ソフトウェア</p>		<p>企業向け産業機器に組み込まれるマイクロソフト 社のソフトウェア。 セキュリティ用ログ長期保存・分析ミドルウェア。</p>